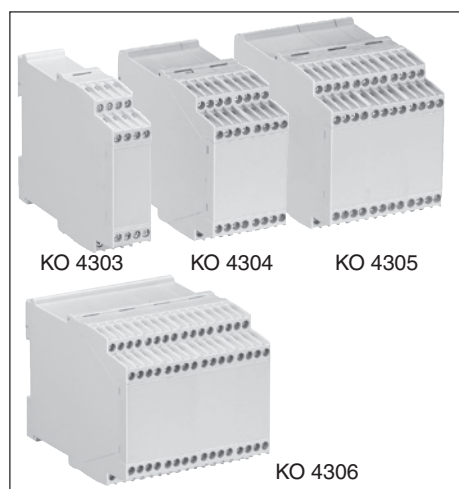


# Boîtiers en matière isolante KO 4300S

avec bornes intégrées sur deux étages  
pour soudure automatique



## Homologations et sigles

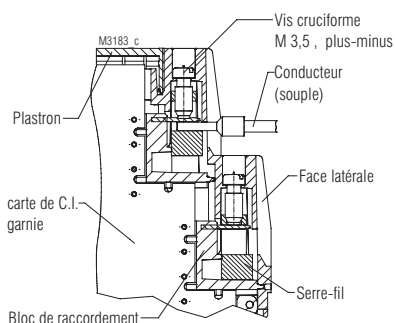


### Vos avantages

- Modulaire, flexible
- Connectique variables
- Designe uniques
- Adaption individuelle

### Propriétés

- Largeur 22,5 / 45 / 67,5 / 90 mm
- Max. 16 / 32 / 48 / 64 bornes
- Surface de plastron large et variable
- Grandes sections raccordables possibles (par ex. 2 x 1,5<sup>2</sup> mm multibrins avec embout)
- Charge admissible max. 16 A
- Soudure automatique possible du bloc de raccordement : grâce à un matériau résistant à la chaleur, celui-ci ne doit plus être recouvert pour passer dans le bain de soudure
- Les grandes vis cruciformes permettent un couple élevé au serrage
- Boîtier homologué IEC 60 439-1 pour la tenue diélectrique
- Possibilité de cartes de C.I. d'épaisseur t = 1,5 mm ou 1 mm
- Plusieurs versions possibles voir "Autres versions"



Borne intégrée sur 2 étages

## Caractéristiques techniques

Largeur [mm]	Profond. [mm]	Référence de commande	Référence	Version
22,5	118	KO4303S.	0054998	standard
			0066602	UL
	97	KO4323S.	0054999	standard
			0066603	UL
45	118	KO4304S.	0055738	standard
			0066604	UL
	97	KO4324S.	0055681	standard
			0066605	UL
67,5	118	KO4305S.	0055671	standard
			0066606	UL
	97	KO4325S.	0055682	standard
			0066607	UL
90	118	KO4306S.	0055672	standard
			0066608	UL
	97	KO4326S.	0055683	standard
			0066609	UL

### Matériau du boîtier

version standard:

PC-GF, gris clair RAL 7035 (éléments du boîtier)

Polyamide (PA4/6), naturel (bloc de raccordement)

version UL:

comme standard, mais, la partie de côtés dans PA66/6, gris clair le RAL 7035

Stabilité de température selon UL 746 B:	PC	PA66/6	PA4/6
	125 °C	120 °C	120 °C
selon Vicat ISO 306			
méth. B:	148 °C	230 °C	290 °C
selon ISO 75-2			
méth. A:	138 °C	225 °C	290 °C
méth. B:	144 °C	235 °C	290 °C

Puissance dissipée max. admiss.: voir diagrammes

Résistance thermique spécifique:

KO 4303S; KO 4304S; KO 4305S: Rth = 6,5 K/W; 5,5 K/W; 4,2 K/W

KO 4324S; KO 4324S; KO 4325S: Rth = 9,0 K/W; 6,5 K/W; 5,4 K/W

Inflammabilité selon UL 94:

V-0

### Nombre de bornes

KO 4303S, KO 4323S:

16

KO 4304S, KO 4324S:

32

KO 4305S, KO 4325S:

48

KO 4306S, KO 4326S:

64

} moins sur demand

Matériau des bornes:

alliage de cuivre nickelé

### Sections raccordables

	AWG	20 - 10	20 - 12
rigide/flexible	mm <sup>2</sup>	1 x 0,5 ... 4 / 0,5 ... 4	2 x 0,5 ... 2,5 / 0,5 ... 2,5
flexible avec embout, sans ou avec collerette plastique	mm <sup>2</sup>	1 x 0,5 ... 2,5	2 x 0,5 ... 1,5
flexible avec embout double et collerette plastique	mm <sup>2</sup>	1 x 0,5 ... 1,5	
longueur à dénuder / embout	mm <sup>2</sup>	8	8

Connectique:

vis cruciformes imperdables M3,5 avec bride solidaire

Couple de serrage:

max. 0,8 Nm

IEC/EN 60 999-1

Résistance intérieure max. vers la carte de C.I.:

10 m Ω

Charge max. admissible:

16 A;

US: 15 A;

CN: 12 A

Connexions internes :

bloc de raccordement soudé automatiquement

**grâce au matériau isolant résistant à la température, le bloc de raccordement ne doit plus être protégé en passant dans le bain de soudure**

Fixation du boîtier:

par encliquetage sur rail

IEC 60 715

Tenue aux courants de fuite

version standard:

CTI 175 ≙ matériau isolant III a

IEC 60 664-1

version UL:

CTI 250 - 400 ≙ matériau isolant III a

IEC 60 664-1

comme standard, mais, la partie de côtés

CTI 550 ≙ matériau isolant II

IEC 60 664-1

## Caractéristiques techniques

**Distances dans l'air et lignes de fuite:** extérieur:  $\geq 6,3$  mm IEC 60 664-1  
intérieur:  $\geq 4,0$  mm IEC 60 664-1

Degré de protection:  
boîtier: IP 40 IEC 60 529  
bornier: IP 20 IEC 60 529  
protection contre les contacts selon VBG

Surface de marquage:  
KO 4303S, KO 4323S: 20,5 x 43,6 mm  
KO 4304S, KO 4324S: 43 x 43,6 mm avec face en 1 partie  
KO 4305S, KO 4325S: 65 x 43,6 mm avec face en 1 partie  
KO 4306S, KO 4326S: 88 x 43,6 mm avec face en 1 parties

**Carte de C.I.:** voir découpe  
Maintien des cartes de C.I.: par glissières dans le capot

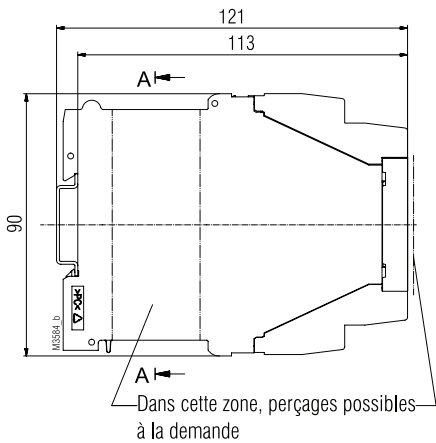
### Autres options:

**D'autres informations sur notice GF23**

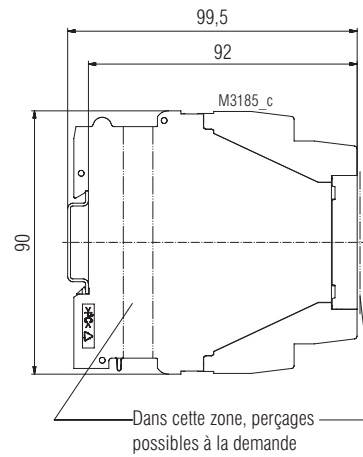
- garnissage variable
- avec borne de terre vers le rail
- ouvertures latérales, par ex. pour liaisons BUS ou fentes d'aération
- ouvertures dans la plaque de fond, par exemple pour connexions BUS vers le rail
- plastron au choix:
  - \* avec volet à bascule
  - \* avec ouvertures à la demande
  - \* Combinaison possible de faces en 22,5 mm et 45 mm de large

## Dimensions

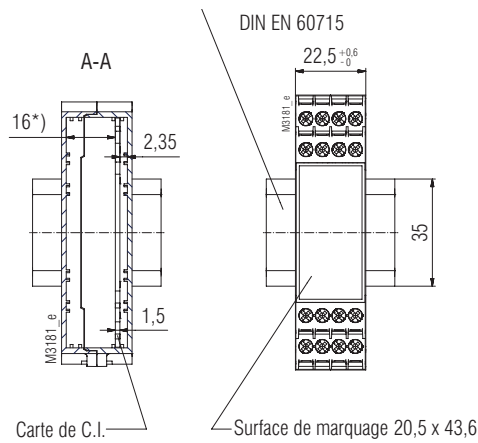
KO 430\_S



KO 432\_S

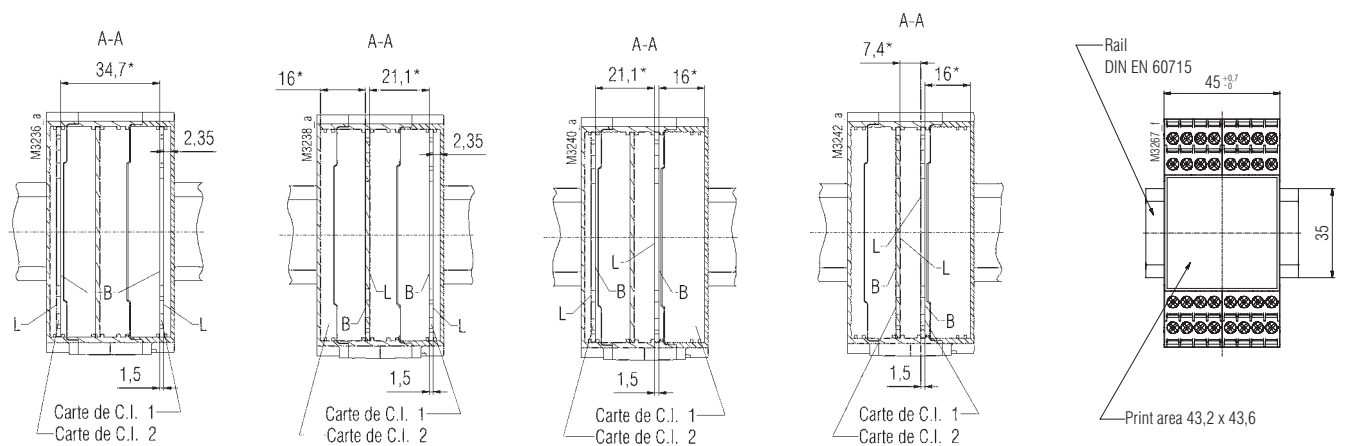


Dispositions de circuits intégrés KO 4303S / KO 4323S



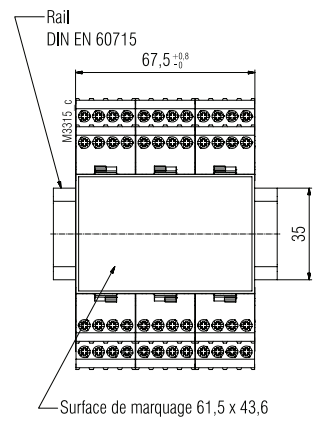
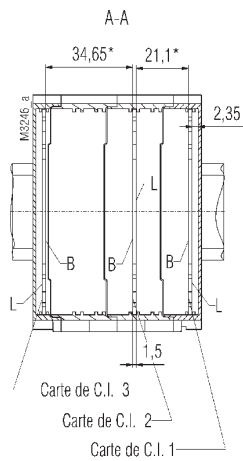
\* 16,5 pour épaisseur de carte t = 1 mm

Dispositions de circuits intégrés KO 4304S / KO 4324S

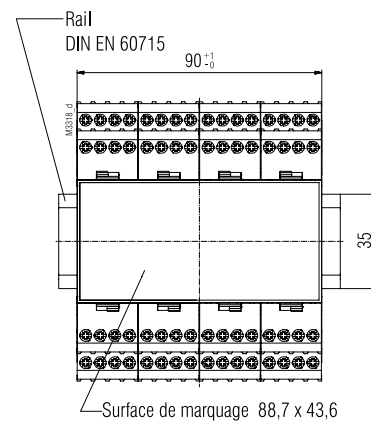
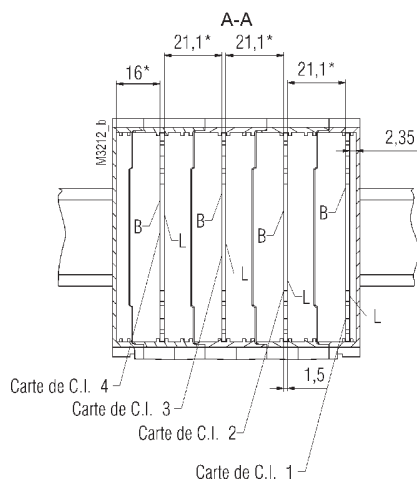


## Dimensions

### Dispositions de circuits intégrés KO 4305S / KO 4325S



### Dispositions de circuits intégrés KO 4306S / KO 4326S



B = Côté composants

L = Côté soudure

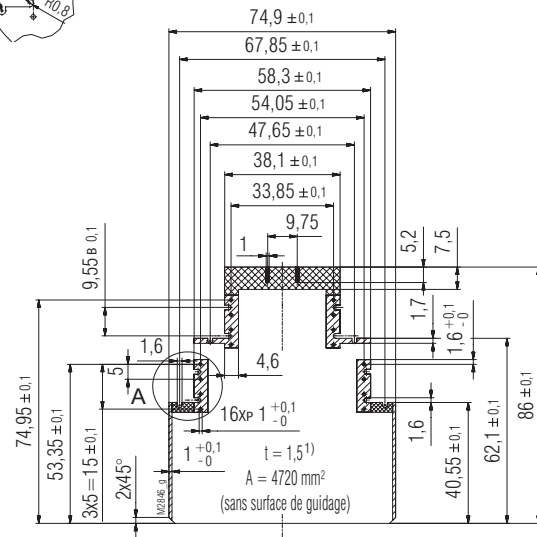
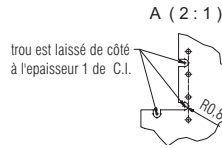
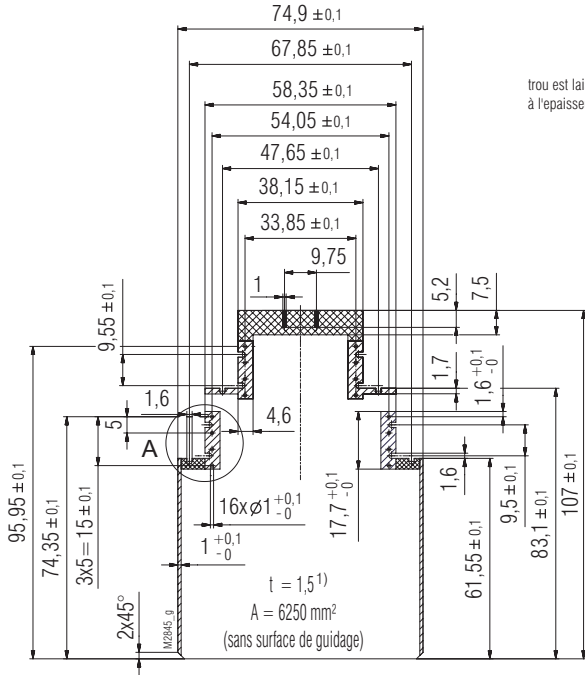
\* = Côté hauteur max.

autres dispositions de circuits intégrés possible

# Découpes des cartes de C.I.

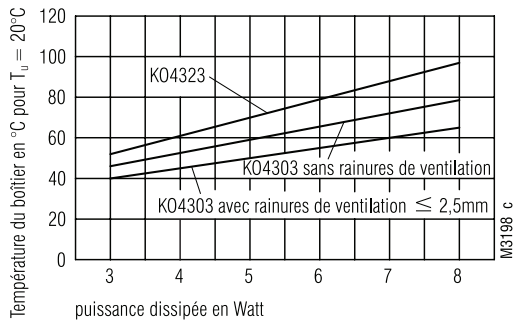
KO 430\_S

KO 432\_S

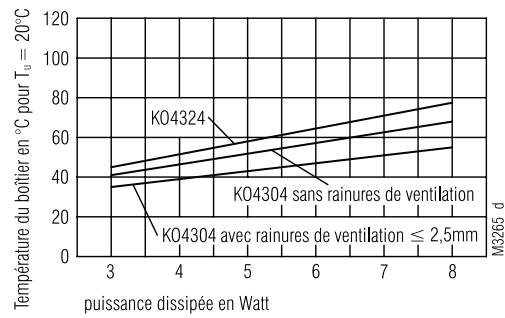


- pastilles de soudure  $\phi 2$
  - ▨ surface de guidage, à laisser libre de composants et matériaux conducteurs
  - ▩ surface de guidage
  - ▧ hauteur de composants réduite (pour épaisseur = 1,5):  
- dessus max. 1,65    - dessous max. 15,2
  - dessus:  
surface de guidage, à laisser libre de composants
  - dessous:  
hauteur de composants réduite max. 14,1 (pour épaisseur = 1,5)
- <sup>1)</sup> tolérance selon DIN EN 60249-2-4

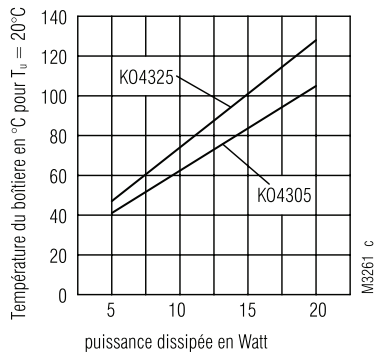
## Diagramme (résistance thermique)



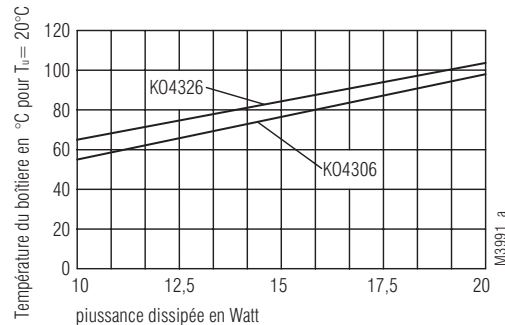
KO 4303S, KO 4323S



KO 4304S, KO 4324S



KO 4305S, KO 4325S

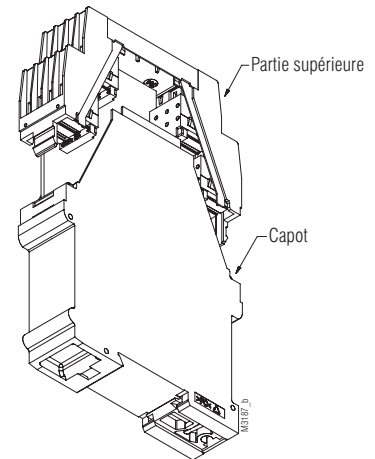
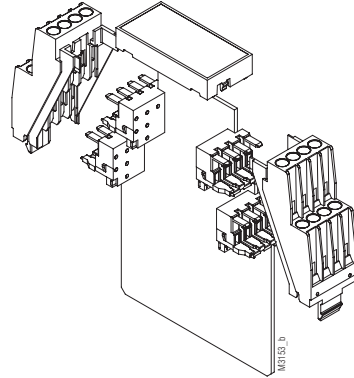
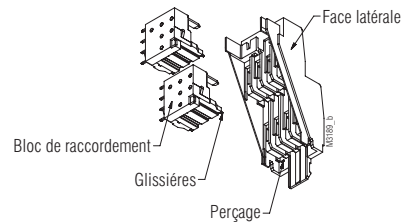


KO 4306S, KO 4326S

## Assemblage du boîtier

### 1. Montage de la partie supérieure

- Poser tous les composants sur une surface plane.
- Faire coulisser les parois latérales au-dessus des blocs de raccordement de la carte de C.I. (les broches de guidage des blocs doivent passer à travers les perçages ménagés sur les deux côtés).
- Encliqueter la face avant sur les côtés pré-assemblés.



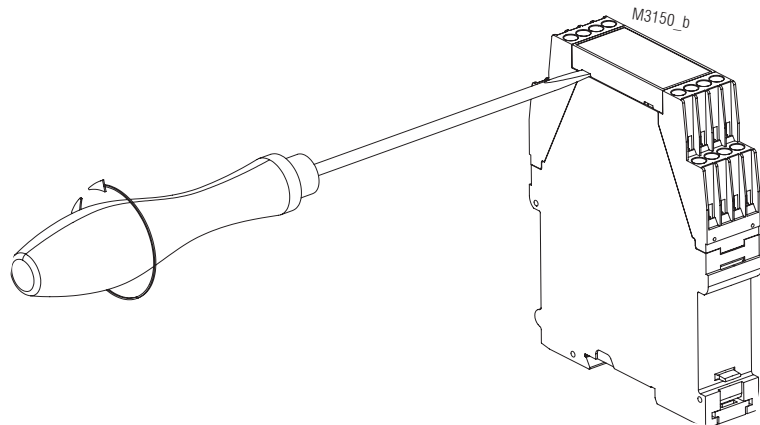
### 2. Montage du boîtier

- Poser tous les composants sur une surface plane.
- Guider la carte de C.I. de la partie supérieure dans les rainures du capot.
- Lors de l'assemblage du capot et de la partie supérieure, veiller à ce que les parois se chevauchent correctement. L'élément de guidage du capot doit venir se caler dans la poche de la partie supérieure.

## Démontage du boîtier

### 1. Démontage du plastron

- Introduire un tournevis dans la fente latérale du plastron.
- Donner un tour de vis



### 2. Démontage de la partie supérieure

- Glisser le tournevis dans le système d'encliquetage du capot jusqu'à la butée.
- Faire basculer le système.
- Retirer du capot la partie supérieure avec la carte de C.I.

